## TIN電極を有するマイクロ波整流用GaNショットキーバリアダイオード

GaN Schottky Barrier Diode with TiN Electrode for Microwave Power Rectification

徳島大院 STS 研<sup>1</sup> e デバイス(株)<sup>2 °(C)</sup>板井 勇樹<sup>1</sup>, 岸 明徳<sup>1</sup>, 李 柳暗<sup>1</sup>, 白石 孝之<sup>1</sup>, 福居 和人<sup>1</sup>, 劉 強<sup>1</sup>, 大野 泰夫<sup>2</sup>, 敖 金平<sup>1</sup>

STS Univ. Tokushima<sup>1</sup>, e-Device Inc.<sup>2</sup> <sup>o</sup>Yuki Itai<sup>1</sup>, Akinori Kishi<sup>1</sup>, Liuan Li<sup>1</sup>, Takayuki Shiraishi, <sup>1</sup>

Kazuhito Fukui<sup>1</sup>, Qiang Liu<sup>1</sup>, Yasuo Ohno<sup>2</sup>, and Jin-Ping Ao<sup>1</sup>

E-mail: itai-y@ee.tokushima-u.ac.jp

近年、電気自動車の充電やエナジーハーベス ティング用無線電力伝送技術が注目されてい る[1]。このような技術において、受電部の RF/ DC 変換効率はレクテナ回路に使用されている ショットキーバリアダイオード(SBD)の特性、 例えばオフ容量、オン抵抗、オン電圧に強く依 存している[2,3]。我々が以前報告したマイク ロ波整流用 GaN SBD は Ni 電極を有するもの であり、オン電圧は 1.16 V であった[4]。今回、 我々はNiの代わりに TiN 電極を用いることで、 GaN SBD の低オン電圧化を実現した。

GaN SBD の断面構造を Fig. 1 に示す。c 面サ ファイア基板上に厚さ3µm、シート抵抗約25 Ωの n+型アクセス層と n 型活性層を成長させ た。n型活性層には、厚さ 0.4 µm、不純物濃度 3×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup>のもの(サンプル1、2)と厚さ1.0 µm、 不純物濃度 1×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup>のもの(サンプル3、4) と2種類のウエハを用意した。製造プロセスと して、誘導結合プラズマ(ICP)ドライエッチン グにより、アノードのメサ形成、パッドのアイ ソレーションを施した。その上、カソード電極 に Ti/Al/Ti/Au (50/200/40/40 nm)を成膜した後、 窒素雰囲気中に850℃、1分間アニールを行い、 オーミック接触を形成した。次にアノードのシ ョットキー電極としてサンプル2、4にはNi/Au (10/10 nm)、サンプルに 1、3 には TiN/Ni/Au (10/5/5 nm)を堆積した。TiN は Ar:N<sub>2</sub> (15:3 sccm)混合ガス雰囲気中反応性スパッタで形成 した[5]。最後に各電極上に厚さ1µmの金膜を メッキで堆積し、300℃、10分間ポストアニー ルを行った。

半径 50  $\mu$ m の円形 SBD の電流-電圧 (*I-V*) 特性よりショットキー障壁高さ $\phi_b$ と理想因子 n 値を算出した。TiN 電極の $\phi_b$ 及びn 値はそれ ぞれ約 0.5 eV と 1.1、Ni 電極には約 0.9 eV と 1.14~1.30 となり、TiN 電極は Ni よりも障壁高 さが低いのに加え、値が均一であった。また、 容量-電圧 (*C-V*) 測定からも TiN 電極の障壁高 さが 0.42 eV、Ni 電極には 1.12 eV であること が得られ、TiN 電極の障壁が低いと確認できた。 面積 2×50  $\mu$ m<sup>2</sup>のフィンガータイプ SBD の *I-V*特性 (Fig. 2) から、TiN 電極のオン電圧は 0.5 V、Ni 電極は 1.2V と求められた。不純物濃 度  $3 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> と  $1 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>のダイオードの オン抵抗がそれぞれ約 15  $\Omega$ 、27  $\Omega$ と、アノ ード金属にほとんど依存しないことが判った。 逆方向の耐圧において、サンプル 1 と 2 は共に 約 40 V となり、サンプル 3 と 4 は共に 100 V を超える耐圧となった。

オン抵抗と耐圧が変わらないものの、TiN 電 極を用いることにより低オン電圧を実現する ことで、RF/DC レクテナ回路の変換効率が改 善されることが期待できる。



Fig. 1 Cross sectional view of the GaN SBD.



Fig. 2 *I-V* characteristics of the diodes with active layer impurity density of  $3 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> and thickness of 0.4  $\mu$ m, in both linear and logarithmic scales.

- K. Takahashi, et al., Jpn. J. Appl. Phys., 48 (2009), 04C095.
- [2] Energy Harvesting Handbook, NTS (2012),43-51
- [3] K. Hayashino, et al., IMWS-IWPT 2012, Kyoto, Japan (2012).
- [4] K. Fukui, et al., IMWS-IWPT 2012, Kyoto, Japan (2012).
- [5] Jin-Ping Ao, et al., Vacuum, 87 (2013), 150-154.